

## 2026 高端研磨抛光材料大会暨半导体与光学材料超精密加工论坛

在晶圆制造材料的成本拆分中，抛光材料约占晶圆制造总成本的7%。抛光液、抛光垫等作为抛光工艺中的核心消耗品，对CeO<sub>2</sub>、SiO<sub>2</sub>、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、SiC、c-BN、金刚石等磨料及各类添加剂提出了更高要求。同时，随着蓝宝石、碳化硅、氮化镓、金刚石等新一代半导体材料的兴起，适用于硬脆材料的高端研磨抛光技术已成为全球研发的重点。

另一方面，光学材料的超精密加工也日益成为高端制造领域的关键环节。在光学领域，如透镜、窗口片、棱镜等对表面粗糙度、面形精度及亚表面损伤控制提出了近乎极限的要求。超精密研磨与抛光技术直接影响光学系统的性能与可靠性，是推动光电产业迈向高端化的重要支撑。当前，该领域正面临高端装备与材料依赖进口的局面，加快相关材料与加工技术的自主创新，已成为我国光学产业升级的迫切需求。

在此背景下，中国粉体网将于2026年4月15日于郑州举办2026高端研磨抛光材料大会暨半导体与光学材料超精密加工论坛。本次大会将汇聚国内行业专家、学者、技术人员及企业代表，围绕高端研磨抛光材料、超精密加工技术、相关装备与应用等议题展开深入交流与研讨。

## 时间：

2025年4月15-16 日一天半会议，4月14 日全天报到

## 地点：

河南郑州 郑州天地丽笙酒店

## 主办单位：

中国粉体网

## 会议主题：

- 1、超精密加工技术与装备发展现状
- 2、抛光材料行业发展现状、应用及需求
- 3、碳化硅、金刚石晶圆的切割、减薄、抛光技术进展
- 4、氧化铝、碳化硅、二氧化硅及稀土抛光磨料的制备及应用现状
- 5、CMP等抛光技术发展现状
- 6、超光滑表面抛光技术及其在光学元件中的应用
- 7、化学机械抛光在半导体晶圆、基板等半导体领域的应用
- 8、碳化硅、氮化硼、金刚石等超硬材料在研磨抛光领域的应用
- 9、抛光液及其添加剂组成（去离子水、磨料、氧化剂、分散剂、pH值调节剂）  
的制备与应用
- 10、抛光磨料纳米化技术发展现状
- 11、抛光垫等重要耗材的制备及开发现状
- 12、研磨抛光材料与技术的高端装备精密部件加工中的应用
- 13、超精密加工装备国产化进展与关键技术突破
- 14、环保型抛光液与磨料开发

## 特色活动:

大会征集参会企业相关技术合作、产品采购，工艺方案等需求进行现场采配活动，相关信息将进行展板展示，提高现场沟通交流效率!

征集内容包含但不限于以下几点:

- 1、行业投资、融资需求
- 2、科研成果转化
- 3、产品工艺问题解决方案
- 4、原料、设备、仪器采购需求

## 会议费用:

2800元/人

## 付款账户:

户名: 粉材供应链管理(山东)有限公司

开户银行: 中国银行股份有限公司临沂北城支行

账户: 226045899651

## 会务组:

联系人: 卢经理

联系方式: 18669538053 (同微信)

